

# JIS

## 表面実装技術－第2部：表面実装用部品 (SMD)の輸送及び保管条件－指針

JIS C 61760-2 : 2023  
(IEC 61760-2 : 2021)  
(JSA)

令和5年11月20日 制定

認定産業標準作成機関 作成・審議

(日本規格協会 発行)

一般財団法人日本規格協会 電子分野産業標準作成委員会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	平 本 俊 郎	東京大学
(委員)	石 井 紀 彦	日本放送協会
	河 村 真紀子	主婦連合会
	西 城 武 志	総務省国際戦略局
	渋 谷 隆	株式会社白山
	諏 訪 正 樹	KOA 株式会社
	内 藤 恵美子	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
	藤 井 哲 郎	東京都市大学名誉教授
	松 井 隆	日本電信電話株式会社
	山 田 誠	大阪公立大学

---

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：令和 5.11.20

担 当 部 署：経済産業省産業技術環境局 国際電気標準課

(〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1)

官 報 掲 載 日：令和 5.11.20

認定産業標準作成機関：一般財団法人日本規格協会

(〒108-0073 東京都港区三田 3-13-12 三田 MT ビル)

素 案 作 成 者：一般社団法人電子情報技術産業協会

(〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-1-3 大手センタービル)

審 議 委 員 会：電子分野産業標準作成委員会 (委員長 平本 俊郎)

この規格についての意見又は質問は、上記認定産業標準作成機関又は素案作成者にご連絡ください。

なお、日本産業規格は、産業標準化法の規定によって、少なくとも5年を経過する日までに見直しが行われ速やかに確認、改正又は廃止されます。

## 目 次

	ページ
序文	1
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 用語及び定義	2
4 一般的条件	2
5 輸送条件	2
5.1 一般的輸送条件	2
5.2 特定輸送条件	3
6 保管条件	3
7 関連文書	4
附属書 A (参考) 輸送条件及び保管条件並びに各分類の説明	5
附属書 X (参考) 旧規格 (JIS C 5070:2009) とこの規格 (JIS C 61760-2) との対照表	11
参考文献	12
解 説	13

## まえがき

この規格は、産業標準化法第 14 条第 1 項の規定に基づき、認定産業標準作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から、産業標準の案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり、経済産業大臣が制定した日本産業規格である。これによって、**JIS C 5070:2009** は廃止され、この規格に置き換えられた。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

**JIS C 61760** 規格群（表面実装技術）は、次に示す部で構成する。

**JIS C 61760-2** 第 2 部：表面実装用部品（SMD）の輸送及び保管条件—指針

**JIS C 61760-3** 第 3 部：スルーホールリフロー（THR）はんだ付け用の部品規格作成の標準的な方法（要求事項）

**JIS C 61760-4** 第 4 部：感湿性部品の分類、包装、表示及び取扱い

# 表面実装技術—第 2 部： 表面実装用部品（SMD）の輸送及び保管条件—指針

## Surface mounting technology— Part 2: Transportation and storage conditions of surface mounting devices (SMD)—Application guide

### 序文

この規格は、2021 年に第 3 版として発行された IEC 61760-2 を基に、技術的内容及び構成を変更することなく作成した日本産業規格である。

なお、この規格で点線の下線を施してある参考事項は、対応国際規格にはない事項である。

### 1 適用範囲

この規格は、能動部品、受動部品などの表面実装用部品（以下、SMD という。）を対象とし、これらの SMD が実装時及び使用時に支障を生じないための、輸送及び保管条件についての指針を示す。ただし、プリント配線板は対象としない。

この規格の目的は、SMD の使用者が品質及び信頼性を低下させることなく、位置決め、はんだ付けなどの処理が可能となるような状態で、SMD の受取り及び保管を確実にすることである。SMD の不適切な輸送及び保管は品質低下を引き起こし、結果として、はんだ付け性不良、剝離及び破裂（ポップコーン現象）のような実装上の問題となる。

**注記** この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を、次に示す。

IEC 61760-2:2021, Surface mounting technology—Part 2: Transportation and storage conditions of surface mounting devices (SMD)—Application guide (IDT)

なお、対応の程度を表す記号“IDT”は、ISO/IEC Guide 21-1 に基づき、“一致している”ことを示す。

### 2 引用規格

次に掲げる引用規格は、この規格に引用されることによって、その一部又は全部がこの規格の要求事項を構成している。これらの引用規格は、記載の年の版を適用し、その後の改正版（追補を含む。）は適用しない。

JIS C 60721-3-1:2022 環境条件の分類—第 3-1 部：環境パラメータ及びその厳しさのグループ別分類—保管条件

**注記** 対応国際規格における引用規格：IEC 60721-3-1:2018, Classification of environmental conditions